

SEMI G57-0302

ガイドライン リードフレーム各部名称の標準

本スタンダードは、Global Assembly and Packaging Committee で技術的に承認されたもので、Japanese Assembly and Packaging Committee が直接責任を負うものである。現版は、2001 年 11 月 26 日 Japanese Regional Standards Committee にて承認されている。2001 年 12 月にまず www.semi.org で入手可能になり、2002 年 3 月発行に至る。初版は 1993 年発行。

1 序文

1.1 目的 — このガイドラインは、半導体回路製造で使用されるリードフレームの各部名称を標準化したものである。

1.2 意義 — 現在、リードフレームの同一名称を異なる名称で使用することにより起きているユーザとサプライヤ間の問題を減ずるために、このガイドラインが使用される。

表 1 図の各部名称

1	Die pad
2	Die Pad Support
3	Lead Lock
4	Anchor Hole
5	Inner Lead
6	Outer Lead
7	Standard Pilot Hole
8	Pilot Hole
9	Top Rail Standard Pilot Hole Side
10	Bottom Rail
11	Lead Cut-off Notch
12	Dam Bar
13	Lead Shoulder
14	Mold Dam
15	Bumper Support Cut-off Notch
16	Lead Lock Groove
17	Mold Line
18	Expansion Slot
19	Down set
20	Die pad Dimple
21	Side Rail
22	Strip Cut-off Line
23	Coined Area
24	Degate Hole

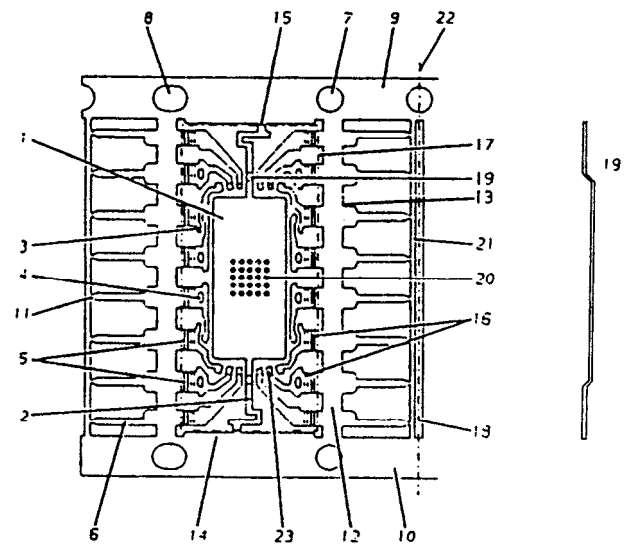


図 1

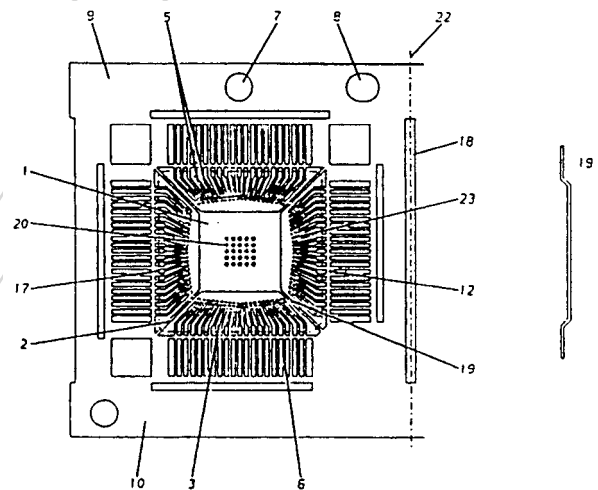


図 2

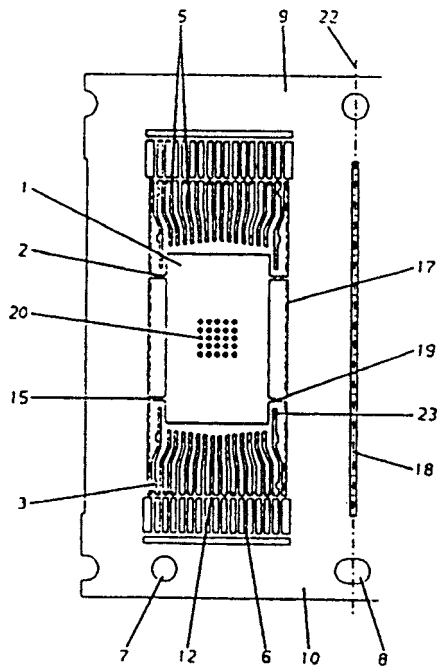


図 3

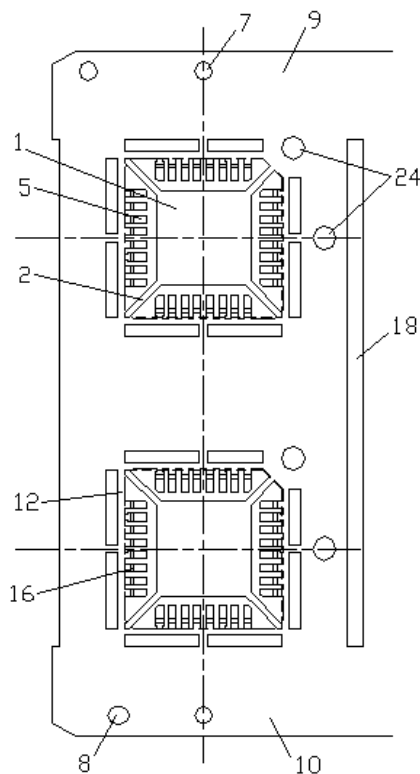


図 4

注意: SEMI は、本書に定められたスタンダードが個々のケースに適するか否かの保証も言明もしていない。スタンダードの適、不適を判断するのは、利用者各位の責任となる。また利用者各位は、ここに記載されている製造者の指示、製品ラベル、製品データシート、そのほかの関連文献を必ず参照のこと。なお、このスタンダードは予告なしに変更されることがある。

このスタンダードに従うために、著作権で保護された資料または特許権で保護された考案を使用する必要がある可能性がある。このスタンダードを発行することにより、SEMI は、このスタンダードの中に記載された各項目に関連する特許権または著作権の効力の有無について責任ある立場にはない。各特許権または著作権の有効性および権利侵害の危険性についての判断は、このスタンダードを使用する利用者各位の責任となる。